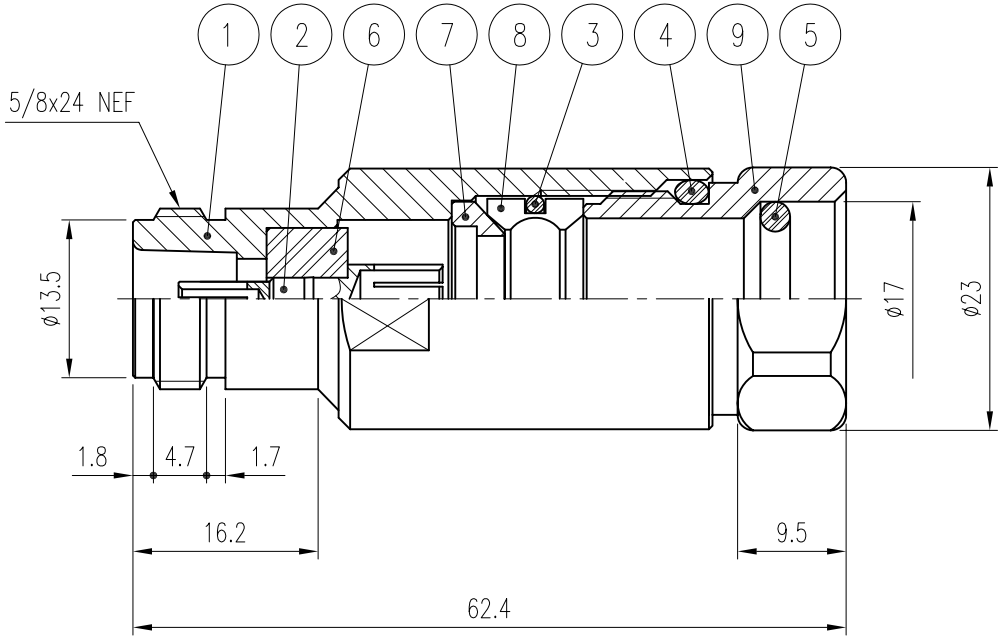
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	도면 양식 변경	손윤호	최영호	2003. 1. 8.



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
9	BACK NUT	1	MBsBD	Silver Plate	DBN00120-5/1 (P8049)
8	INSERT	2	MBsBD	Silver Plate	DIS00100-5/1 (M8048)
7	INSERT	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00099-5/1 (M8042)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01043-N/1 (H8160)
5	GASKET	1	SILICON		DGK00041-N/1 (G5009)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00140-N/1 (G8029)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00098-N/1 (G8028)
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate	DCT01142-5/1 (E8218)
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	DBD01494-5/1 (D8237)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2002. 6. 7.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 NS 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 1/2" F N-J

A4

도번 CN00462-7/1

K345-241-000